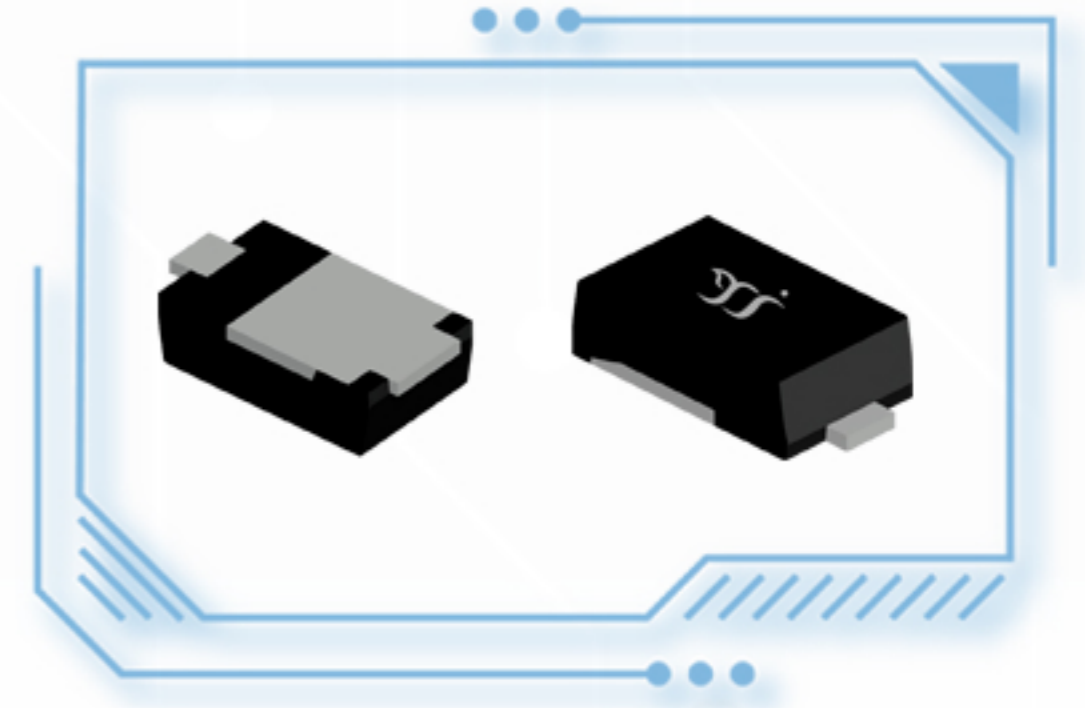


SOD-123HE二极管

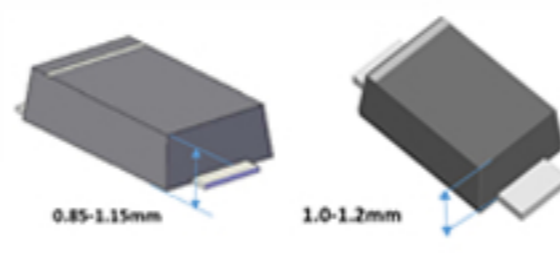
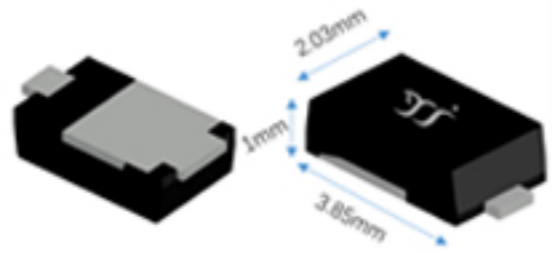
产品介绍

- 1.超薄封装外形，可应用于小型化、薄型化电路；
- 2.封装底面带有散热片，散热性能优；
- 3.封装芯片种类多，可封装GPP、DB、肖特基、FRED、TVS等芯片；
- 4.产品采用环保物料，符合RoHS标准；
- 5.产品广泛应用于次级整流电路，转换器，续流二极管，交/直流电源防护等。



产品特点

- 1.散热性能优:背面Pad面积大，散热性能好，通流能力强，能满足高温应用需求；
- 2.封装外形薄:比SOD-123FL封装更薄，满足封装薄型化的发展趋势；



电性参数

Series		Peak power dissipation @10/1000μs waveform	Working Peak Reverse Voltage VRWM (V)	Maximum Reverse Surge Current IPP @10/1000μs waveform (A)	Package
SMFE Series	Uni/Bi	200W	5.0-400	0.31-21.74	SOD-123HE
SM4FE Series	Uni/Bi	400W	8.5-220	1.12-27.78	SOD-123HE

更多产品详见官网

应用领域

